

실적으로 증명할 한 해

Analyst 과민정

02-3787-2160 jessica.kwang@hmsec.com

RA 윤서영

02-3787-2020 seoyeong.yoon@hmsec.com

현재주가 (4/19)	136,400원		
상승여력	90.6%		
시가총액	13,277십억원		
발행주식수	96,994천주		
자본금/액면가	13십억원/100원		
52주 최고가/최저가	146,300원/19,600원		
일평균 거래대금 (60일)	309십억원		
외국인지분율	14.01%		
주요주주	곽동신 외 7 인 55.06%		
추가상승률	1M	3M	6M
절대주가(%)	46.0	136.4	132.4
상대주가(%p)	49.7	125.5	116.6

* K-IFRS 연결 기준

(단위: 원)	EPS(24F)	EPS(25F)	T/P
Before	2,121	3,434	260,000
After	1,713	4,241	260,000
Consensus	1,741	2,265	155,500
Cons. 차이	-1.6%	87.2%	67.2%

최근 12개월 추가수익률



자료: FnGuide, 현대차증권

요약 실적 및 Valuation

구분	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EBITDA (십억원)	EPS (원)	증감율 (%)	P/E (배)	P/B (배)	EV/EBITDA (배)	ROE (%)	배당수익률 (%)
2022	328	112	92	121	934	-10.9	12.3	2.9	8.4	25.0	1.7
2023	159	35	267	43	2,745	193.9	22.5	10.5	134.8	55.5	0.7
2024F	586	233	166	241	1,713	-37.6	79.6	18.9	54.4	26.2	0.3
2025F	998	415	411	424	4,241	147.7	32.1	12.4	30.9	46.6	0.3
2026F	1,596	708	692	717	7,133	68.2	19.1	7.7	17.9	49.6	0.3

* K-IFRS 연결 기준

투자포인트 및 결론

- 동사는 1Q24 실적발표를 통해 매출액 773억원 (+48.1% qoq, +191.5% yoy), 영업이익 287억원(+55.9% qoq, +1,283.5% yoy)로 당사 추정치를 뛰어넘는 호실적을 보여줌. 특히 영업이익의 증가가 두드러졌음. 이는 동사가 국내외 양사 HBM3E형 Dual TC Bonder를 유일하게 공급하는 글로벌 업체로서 독점적인 지위를 보이는 반증이라고 판단
- <그림 2>에서 보여지듯, 2024년 기준 영업이익률 40%를 상회하는 반도체 장비 업체는 글로벌 4개사 뿐으로 당사 역시 Dual TC Bonder의 독점적인 지위로 인해 영업이익률 상승세가 이어질 것
- 2024년 4월 19일 동사는 확장되고 있는 AI 반도체용 HBM 시장 성장에 대응하기 위해 6번째 신공장을 개소, 총 2만 2,000명 규모의 생산 라인 확보를 통해 대응할 계획이라고 밝힘

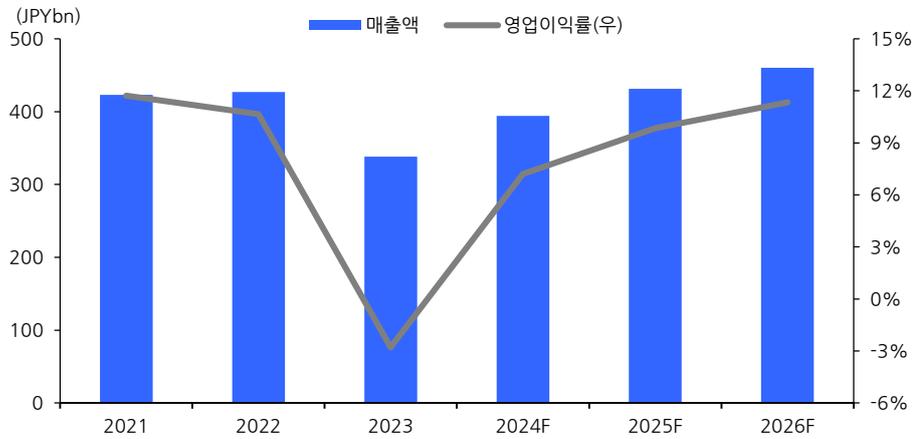
AI용 HBM 시장 잠재력 무한

- 당사가 체크한 바에 따르면, Nvidia와 미국 하이퍼스케일러 업체들의 지속적으로 강한 수요와 엔비디아의 신규 GPU B200, GB200 등에 더 많은 HBM3e를 탑재하려고 하는 요구, 기존 8단 HBM3e의 메모리 용량 192GB 대비 12단 HBM3e의 메모리 용량은 288GB로 증가함에 따라 HBM의 웨이퍼 사용량은 현재 대비 10~20% 증가할 것으로 전망됨. 마이크론도 HBM의 웨이퍼 사용량이 기존 메모리 대비 3배 이상 높다고 한 발언에 주목할 필요가 있다고 판단함. 이러한 이유로 마이크론의 HBM capa 할당은 전체 캐파의 25~30%까지 확대될 전망
- SK하이닉스 역시 AI 반도체용 HBM 시장 성장과 함께 시장 리더십을 지속하기 위해 캐파 확대가 이루어질 것으로 전망됨. 당사가 지속적으로 언급하고 있듯이, SK하이닉스와 TSMC의 Alliance 강화에 따라 2026년 양산 계획인 HBM4에서도 동사의 Dual TC Bonder에 대한 기술 경쟁력이 입증될 것
- 동사는 TC 본딩 전후 HBM 다이와 완성된 HBM 웨이퍼를 검사하는 장비를 공급하는 글로벌 유일의 후공정 검사 장비 업체임. 최근 선보인 HBM 6 Side Inspection 장비는 TSV 공법으로 적용된 반도체 Die 6면을 비전 검사를 통해 불량률을 최소화하는 장비로, 생산성과 정밀도가 향상됨에 따라 향후 매출에 크게 기여하는 주력 장비가 될 것으로 기대되며, 2.5D Advanced Packaging 장비 또한 관련 반도체 장비업체들에게 발주내고 있다는 점에서 동사는 독보적인 입지를 확보할 것

강력한 Dual TC Bonder 기술 리더십 → 동사의 수익성으로 보여질 것

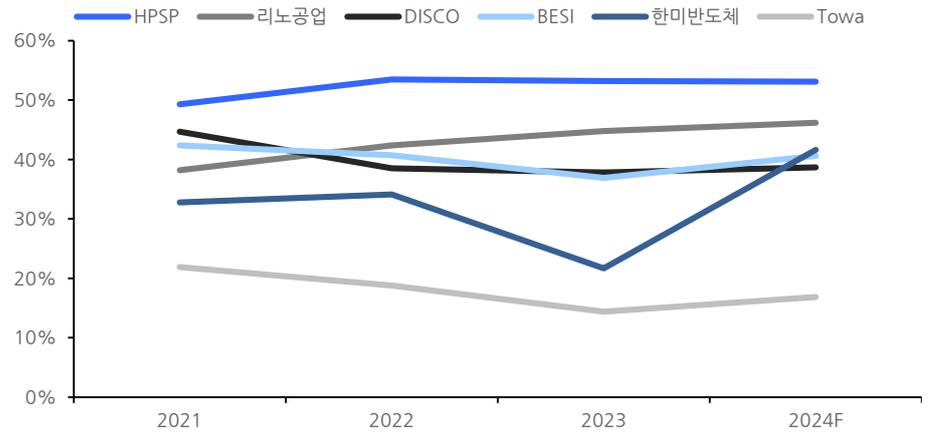
- 미국은 지난 4월 18일~19일 미국 정부 주도로 Advanced Packaging 전략과 관련한 컨퍼런스를 개최. 이를 통해 미국내 서플라이체인 구축을 견고히 할 것임을 재입증함
- 1) 동사의 기술적 우위를 바탕으로 한 Dual-TC Bonder의 독점적인 시장 지배력 확대, 2) SK하이닉스의 16단 HBM3E의 All-Around Power TSV 구현을 위한 동사의 Dual TC Bonder 및 TC 본딩 전후로 검사장비가 요구되는데 HBM 6 Side Inspection 장비가 동사의 실적에 크게 기여하는 주력 장비가 될 것.
- 최근 논란의 여지가 되고 있는 하이브리드 본딩 장비 역시 동사가 우선적으로 개발할 경우, 글로벌 메모리향 하이브리드 본딩로서의 위치를 확고히 할 것

<그림1> 레조낙 전자소재 사업부 실적 추이



자료 : Bloomberg, 현대차증권

<그림2> 2024년 기준 영업이익률 40%이상을 기록하는 업체는 글로벌로도 4개사 뿐



주: 2024년 Bloomberg 컨센서스 추정치

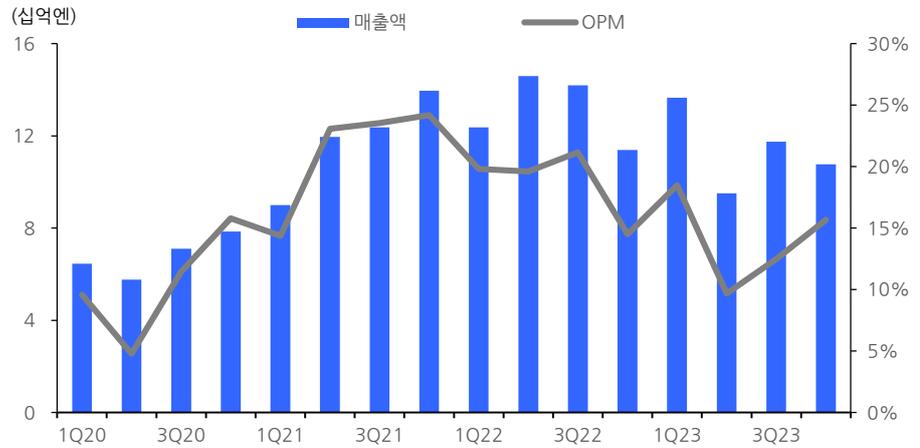
자료 : Bloomberg, 현대차증권

<그림3> 미국내 Advanced Packaging 서플라인 체인 구축 로드맵



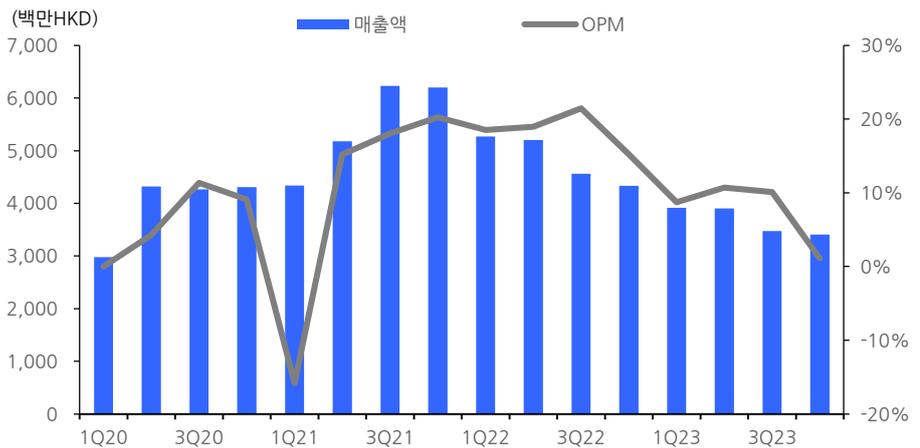
자료 : 미 상무부, 현대차증권

<그림4> Towa 실적 추이



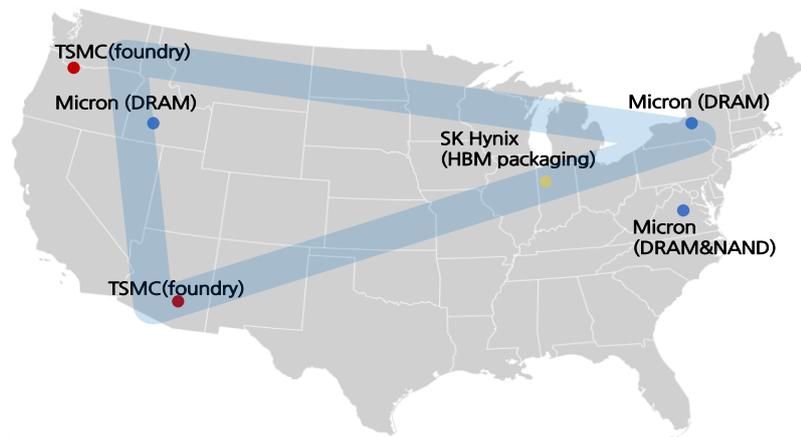
자료 : Bloomberg, 현대차증권

<그림5> ASMP 실적 추이



자료 : Bloomberg, 현대차증권

<그림6> 미국내 AI Alliance 강화



자료 : Google, 현대차증권

<표1> 한미반도체 실적 추이 및 전망

(단위: 십억원, %)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24P	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F
매출액	26.5	49.1	31.2	52.2	77.3	139.9	169.7	198.9	327.6	159.0	585.8
MSVP	11.6	30.5	18.0	21.1	11.1	11.9	15.5	32.1	195.5	81.2	70.6
Bonder	1.0	5.1	0.5	17.3	47.1	98.8	118.1	129.1	26.0	23.9	393.0
6면검사					4.3	12.6	16.5	21.9			55.3
C/M	6.6	2.1	0.0	2.0	0.0	0.5	2.1	3.2	16.8	10.8	5.8
EMI Shield	0.0	0.4	3.3	1.8	6.7	6.5	6.1	2.4	8.3	5.6	21.7
부품(S,K,T)	6.1	8.1	8.9	8.8	7.4	7.8	9.3	6.9	47.0	32.0	31.4
기타	1.2	2.8	0.5	1.2	0.8	1.8	2.1	3.3	34.0	5.6	8.0
영업이익	2.1	11.2	2.9	18.4	28.7	54.7	67.9	82.1	111.9	34.5	233.4
영업이익률	7.8%	22.8%	9.3%	35.2%	37.1%	39.1%	40.0%	41.3%	34.1%	21.7%	39.8%

자료 : 한미반도체, 현대차증권

<표2> 1Q24 실적 review

(단위: 십억원, %)

	1Q23	분기실적		증감		당사전망치		컨센서스	
		4Q23	1Q24P	(YoY)	(QoQ)	1Q24P	Diff.	1Q24P	Diff.
매출액	27	52	77	191.5%	48.1%	75	3.6%	78	-1.4%
영업이익	2	18	29	1283.5%	55.9%	26	9.1%	27	4.5%
세전순이익	175	110	-	N/A	N/A	38	N/A	26	N/A
순이익	133	85	-	N/A	N/A	33	N/A	21	N/A

자료 : FnGuide, 현대차증권

〈표3〉 한미반도체 반도체 장비 공급계약에서 도출되는 평균 리드타임 (2020년)

(단위: 개월)

업체	공급지역	시작일	종료일	리드타임
SK하이닉스	한국	2020-01-07	2020-03-31	2.8
Shenzhen Mifei Tech	중국	2020-01-09	2020-04-01	2.8
Suzhou ASEN Semi	중국	2020-01-09	2020-02-14	1.2
ASE	중국	2020-01-09	2020-02-27	1.6
NXP Semi Malaysia	말레이시아	2020-01-30	2020-04-16	2.6
UTAC DongGuan	중국	2020-02-04	2020-04-30	2.9
Siliconware Tech	중국	2020-02-28	2020-03-06	0.2
GTBF	중국	2020-03-14	2020-04-28	1.5
JCET	중국	2020-03-16	2020-05-05	1.7
USI	중국	2020-04-07	2020-05-12	1.2
Skyworks	중국	2020-04-14	2020-05-15	1.0
Skyworks	멕시코	2020-05-27	2020-06-10	0.5
SK하이닉스	한국	2020-05-29	2020-09-17	3.7
Skyworks	멕시코	2020-06-13	2020-08-07	1.8
Skyworks	멕시코	2020-06-19	2020-09-01	2.5
ASE	대만	2020-09-08	2020-10-30	1.7
Bosch 헝가리	헝가리	2020-09-10	2021-04-01	6.8
Skyworks	멕시코	2020-09-11	2020-10-31	1.7
화천과기	중국	2020-10-05	2020-12-09	2.2
UNIMICRON	대만	2020-10-05	2021-05-15	7.4
ASE	대만	2020-10-16	2020-12-30	2.5
화천과기	중국	2020-10-23	2021-01-10	2.6
QORVO	중국	2020-11-02	2020-12-30	1.9
ASE	대만	2020-11-03	2021-01-04	2.1
UTAC DongGuan	중국	2020-11-05	2021-02-11	3.3
ASE	대만	2020-11-05	2021-03-19	4.5
화천과기	중국	2020-11-20	2021-04-06	4.6
ASE	대만	2020-11-30	2021-02-25	2.9
UTAC DongGuan	중국	2020-11-30	2021-05-08	5.3
Forehope elec	중국	2020-12-04	2021-09-10	9.3
Suzhou ASEN Semi	중국	2020-12-08	2020-12-31	0.8
Unisem	말레이시아	2020-12-18	2021-04-19	4.1
브로드컴 싱가포르	한국	2020-12-22	2021-02-10	1.7
평균리드타임				2.8

자료 : 한미반도체, 현대차증권

<표4> 한미반도체 반도체 장비 공급계약에서 도출되는 평균 리드타임(2021년)

(단위: 개월)

업체	공급지역	시작일	종료일	리드타임
ASE	대만	2021-01-07	2021-04-09	3.1
SPIL	대만	2021-01-08	2021-03-30	2.7
OSE	대만	2021-01-08	2021-05-14	4.2
화천과기	중국	2021-01-11	2021-08-27	7.6
화천과기	중국	2021-01-11	2021-07-13	6.1
엠코	한국	2021-01-19	2021-05-30	4.4
화천과기	중국	2021-01-20	2021-10-15	8.9
화천과기	중국	2021-01-20	2021-10-22	9.2
ASE	대만	2021-01-22	2021-05-31	4.3
Luxshre Precision	대만	2021-01-28	2021-10-31	9.2
Qiliang Elec(SPIL)	중국	2021-02-05	2021-12-31	11.0
ASE	대만	2021-02-10	2021-07-16	5.2
NXP semi Taiwan	대만	2021-02-17	2021-09-30	7.5
ASE	대만	2021-02-23	2021-06-30	4.2
Forehope elec	중국	2021-03-08	2021-12-31	9.9
SPIL	중국	2021-03-09	2021-03-09	0.0
SK하이닉스	한국	2021-03-10	2021-11-30	8.8
난야 PCB	대만	2021-03-15	2021-10-30	7.6
UNIMICRON	대만	2021-03-15	2021-10-29	7.6
ASE	중국	2021-03-29	2021-12-31	9.2
JCET	중국	2021-03-31	2021-12-31	9.2
ASE	말레이시아	2021-04-01	2021-12-01	8.1
HuaTian	중국	2021-04-08	2021-11-15	7.4
마이크론메모리	말레이시아	2021-04-13	2021-10-08	5.9
ASE	대만	2021-04-29	2021-12-30	8.2
ASE	대만	2021-05-03	2022-04-30	12.1
SPIL	대만	2021-05-10	2021-12-03	6.9
TI 말레이시아	말레이시아	2021-05-13	2022-03-31	10.7
SPIL	대만	2021-05-13	2022-05-01	11.8
UNIMICRON	중국	2021-05-13	2021-10-31	5.7
Chipacking	중국	2021-06-04	2021-11-28	5.9
UTAC Thai	태국	2021-06-07	2021-09-03	2.9
UNIMICON	대만	2021-06-21	2022-04-30	10.4
난야 PCB	대만	2021-06-23	2022-03-04	8.5
삼성전기	한국	2021-07-01	2022-02-28	8.1
SPIL	대만	2021-08-10	2021-12-30	4.7
ASE	대만	2021-08-12	2022-02-28	6.7
SK하이닉스	한국	2021-08-13	2022-03-31	7.7
UTAC Thai	태국	2021-08-14	2021-12-08	3.9
JSSI	중국	2021-08-19	2022-05-31	9.5
TI 말레이시아	말레이시아	2021-09-23	2022-01-31	4.3
SONY 태국	태국	2021-09-24	2022-03-10	5.6
RF360	중국	2021-09-30	2022-02-10	4.4
Infineon	말레이시아	2021-10-11	2022-10-01	11.8
UNIMICRON	대만	2021-10-08	2022-05-31	7.8

자료 : 한미반도체, 현대차증권

<표5> 한미반도체 반도체 장비 공급계약에서 도출되는 평균 리드타임(2021년)

(단위: 개월)

업체	공급지역	시작일	종료일	리드타임
SONY 태국	태국	2021-11-05	2022-06-01	6.9
Unisem	중국	2021-11-10	2022-11-18	12.4
ASE	대만	2021-12-02	2022-04-30	5.0
Rohm	필리핀	2021-12-06	2022-10-31	11.0
코리아씨키트	한국	2021-12-06	2022-05-06	5.0
난야 PCB	대만	2021-12-07	2023-01-23	13.7
난야 PCB	중국	2021-12-07	2023-01-31	14.0
Chipmos	대만	2021-12-24	2022-11-30	11.4
ASE	중국	2021-12-24	2022-04-29	4.2
ASE	대만	2021-12-24	2022-04-08	3.5
평균리드타임				7.4

자료 : 한미반도체, 현대차증권

<표6> 한미반도체 반도체 장비 공급계약에서 도출되는 평균 리드타임(2022년)

(단위: 개월)

업체	공급지역	시작일	종료일	리드타임
Access	중국	2022-01-13	2022-05-31	4.6
UNIMICRON	중국	2022-04-29	2022-10-31	6.2
난야 PCB	대만	2022-05-11	2023-01-15	8.3
UTAC	태국	2022-05-11	2022-10-15	5.2
ASE	대만	2022-05-17	2022-09-30	4.5
Infineon	말레이시아	2022-06-27	2022-10-01	3.2
QORVO	중국	2022-07-01	2022-10-10	3.4
난야 PCB	중국	2022-07-01	2022-12-12	5.5
코리아씨키트	한국	2022-07-06	2023-01-05	6.1
SK하이닉스	한국	2022-07-07	2022-12-30	5.9
난야 PCB	대만	2022-11-11	2023-09-08	10.0
평균리드타임				5.7

자료 : 한미반도체, 현대차증권

주 : 강조는 HBM3용 Dual TC 본더 첫 수주

<표7> 한미반도체 반도체 장비 공급계약에서 도출되는 평균 리드타임(2023년)

(단위: 개월)

업체	공급지역	시작일	종료일	리드타임
Forehope elec	중국	2023-05-30	2023-08-31	3.1
Infineon Technologies	싱가포르	2023-06-12	2023-10-24	4.5
UNIMICRON	대만	2023-06-12	2023-09-20	3.3
Zhengzhou Xinghang	중국	2023-06-22	2023-09-28	3.3
SK하이닉스	한국	2023-08-31	2024-04-05	7.3
SK하이닉스	한국	2023-09-27	2024-04-21	6.9
평균리드타임				4.7

자료 : 한미반도체, 현대차증권

<표8> 한미반도체 반도체 장비 공급계약에서 도출되는 평균 리드타임(2024년)

(단위: 개월)

업체	공급지역	시작일	종료일	리드타임
SK하이닉스	한국	2024-02-01	2024-07-02	5.1
SK하이닉스	한국	2024-03-21	2024-07-02	3.4
Micron	미국	2024-04-10	2024-07-08	7.5
평균리드타임				5.3

자료 : 한미반도체, 현대차증권

주 : 강조는 HBM3E용 Dual TC 본더 첫 수주

(단위:십억원)

포괄손익계산서	2022	2023	2024F	2025F	2026F
매출액	328	159	586	998	1,596
증가율 (%)	-12.2	-51.5	268.4	70.4	59.9
매출원가	143	80	217	352	519
매출원가율 (%)	43.5	50.1	37.1	35.3	32.5
매출총이익	185	79	369	646	1,077
매출이익률 (%)	56.5	49.9	62.9	64.7	67.5
증가율 (%)	2.7	-57.1	364.4	75.2	66.7
판매관리비	73	45	135	231	369
판매비율 (%)	22.3	28.2	23.1	23.1	23.1
EBITDA	121	43	241	424	717
EBITDA 이익률 (%)	36.8	27.2	41.1	42.5	44.9
증가율 (%)	-6.4	-64.2	457.4	75.9	69.3
영업이익	112	35	233	415	708
영업이익률 (%)	34.1	21.7	39.8	41.6	44.4
증가율 (%)	-8.6	-69.1	575.0	78.0	70.5
영업외손익	15	306	-20	112	180
금융수익	20	18	-29	114	196
금융비용	10	10	26	27	33
기타영업외손익	4	299	35	25	17
종속관계기업관련손	1	4	0	0	0
세전계속사업이익	128	345	214	528	888
세전계속사업이익률	39.0	217.1	36.5	52.9	55.6
증가율 (%)	-6.2	170.1	-38.1	147.0	68.2
법인세비용	36	78	47	116	196
계속사업이익	92	267	166	411	692
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	92	267	166	411	692
당기순이익률 (%)	28.2	168.0	28.4	41.2	43.3
증가율 (%)	-11.7	189.6	-37.7	147.2	68.2
차배주주지분 순이익	92	267	166	411	692
비차배주주지분 순이익	0	0	0	0	0
기타포괄이익	1	-1	0	0	0
총포괄이익	93	266	166	411	692

(단위:십억원)

현금흐름표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
영업활동으로인한현금흐름	110	45	119	21	188
당기순이익	92	267	166	411	692
유형자산 상각비	8	8	7	8	9
무형자산 상각비	0	0	0	0	0
외환손익	2	-4	0	0	0
운전자본의감소(증가)	-7	27	-99	-299	-339
기타	13	-254	45	-100	-175
투자활동으로인한현금흐름	-18	85	-110	57	133
투자자산의 감소(증가)	2	-210	-36	-23	-30
유형자산의 감소	1	2	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-9	-28	-28	-20	-11
기타	-12	320	-46	99	174
재무활동으로인한현금흐름	-51	-44	-39	-39	-38
차입금의 증가(감소)	1	-1	2	1	2
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	5	0	0	0
배당금	-30	-19	-41	-41	-41
기타	-22	-29	0	0	0
기타현금흐름	1	3	0	0	0
현금의증가(감소)	41	89	-29	38	282
기초현금	50	91	180	151	189
기말현금	91	180	151	189	472

* K-IFRS 연결 기준

(단위:십억원)

재무상태표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
유동자산	270	319	416	828	1,521
현금성자산	91	180	152	182	439
단기투자자산	13	0	1	2	3
매출채권	80	41	135	366	596
재고자산	80	95	115	260	454
기타유동자산	5	3	12	18	30
비유동자산	186	404	461	495	526
유형자산	113	127	147	159	161
무형자산	4	4	4	4	4
투자자산	54	263	299	321	351
기타비유동자산	15	11	11	11	11
기타금융업자산	0	0	0	0	0
자산총계	455	724	876	1,323	2,047
유동부채	63	105	172	253	346
단기차입금	0	0	0	0	0
매입채무	12	18	70	103	168
유동성장기부채	0	0	0	0	0
기타유동부채	51	87	102	150	179
비유동부채	2	47	6	8	14
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
장기금융부채	0	0	0	0	0
기타비유동부채	2	47	6	8	14
기타금융업부채	0	0	0	0	0
부채총계	65	152	178	261	360
지배주주지분	390	572	698	1,069	1,720
자본금	13	13	13	13	13
자본잉여금	51	56	56	56	56
자본조정 등	0	-30	-30	-30	-30
기타포괄이익누계액	1	0	0	0	0
이익잉여금	325	532	658	1,029	1,680
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	390	572	698	1,069	1,720

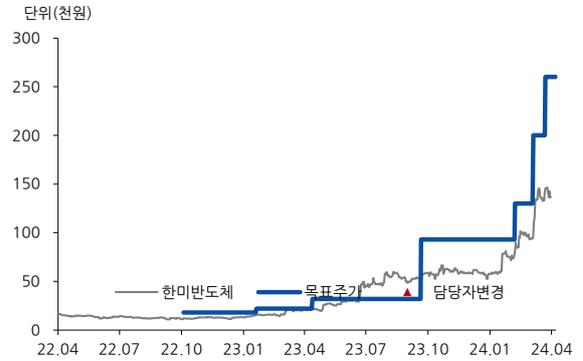
(단위:원, 배, %)

주요투자지표	2022	2023	2024F	2025F	2026F
EPS(당기순이익 기준)	934	2,745	1,713	4,241	7,133
EPS(지배순이익 기준)	934	2,745	1,713	4,241	7,133
BPS(자본총계 기준)	4,008	5,875	7,194	11,018	17,733
BPS(지배지분 기준)	4,008	5,875	7,194	11,018	17,733
DPS	200	420	420	420	420
P/E(당기순이익 기준)	12.3	22.5	79.6	32.1	19.1
P/E(지배순이익 기준)	12.3	22.5	79.6	32.1	19.1
P/B(자본총계 기준)	2.9	10.5	18.9	12.4	7.7
P/B(지배지분 기준)	2.9	10.5	18.9	12.4	7.7
EV/EBITDA(Reported)	8.4	134.8	54.4	30.9	17.9
배당수익률	1.7	0.7	0.3	0.3	0.3
성장성 (%)					
EPS(당기순이익 기준)	-10.9	193.9	-37.6	147.7	68.2
EPS(지배순이익 기준)	-10.9	193.9	-37.6	147.7	68.2
수익성 (%)					
ROE(당기순이익 기준)	25.0	55.5	26.2	46.6	49.6
ROE(지배순이익 기준)	25.0	55.5	26.2	46.6	49.6
ROA	20.9	45.3	20.8	37.4	41.1
안정성 (%)					
부채비율	16.7	26.6	25.4	24.4	20.9
순차입금비율	순현금	순현금	순현금	순현금	순현금
이자보상배율	923.9	437.2	706.9	633.5	687.7

▶ 투자 의견 및 목표주가 추이

일자	투자 의견	목표주가	과리율(%)	
			평균	최고/최저
2022.10.24	BUY	18,000	-28.59	-14.50
2023.02.09	BUY	22,000	-18.19	-1.82
2023.05.03	BUY	32,000	25.71	86.88
2023.10.11	BUY	93,000	-34.44	-12.90
2024.02.27	BUY	130,000	-26.32	-22.00
2024.03.25	BUY	200,000	-33.03	-27.25
2024.04.12	BUY	260,000	-46.01	-43.73
2024.04.22	BUY	260,000		

▶ 최근 2년간 한미반도체 주가 및 목표주가



▶ Compliance Note

- 동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 지분율 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료에 언급된 종목의 유가증권(DR, CB, IPO, 시장조성) 발행과 관련하여 지난 6개월간 주간사로 참여하지 않았습니다.
- 당사는 추천일 현재 한미반도체로부터 자사주 금전신탁 위탁을 받아 업무를 수행하고 있습니다.
- 조사분석 담당자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 이 자료에 게재된 내용들은 자료작성자 객관성의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

▶ 투자 의견 분류

- ▶ 업종 투자 의견 분류 현대차증권의 업종투자 의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 업종 펀더멘털과 업종주가의 전망을 의미함.
 - OVERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 개선과 함께 업종주가의 상승 기대
 - NEUTRAL : 업종 펀더멘털상의 유의미한 변화가 예상되지 않음
 - UNDERWEIGHT : 업종 펀더멘털의 악화와 함께 업종주가의 하락 기대
- ▶ 현대차증권의 종목투자 의견은 3등급으로 구분되며 향후 6개월간 추천기준일 증가대비 추천종목의 예상 상대수익률을 의미함.
 - BUY : 추천일 증가대비 초과수익률 +15%P 이상
 - MARKETPERFORM(M.PERFORM) : 추천일 증가대비 초과수익률 -15% ~ +15%P 이내
 - SELL : 추천일 증가대비 초과수익률 -15%P 이하

▶ 투자등급 통계 (2023.04.01~2024.03.31)

투자등급	건수	비율(%)
매수	147건	91.3%
보유	14건	8.7%
매도	0건	0%

- 본 조사자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 당사의 사전 동의 없이 무단복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다.
- 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.